

Ion Padを用いた搬送工程の改善

Improve the transfer part by using Ion Pad

最新プロセスで選ばれています

have chosen by the latest process

最先端の半導体製造プロセスにおける導入実績多数 デフォーカス対策、タクトタイム改善

Many achievements in cutting-edge semiconductor manufacturing processes
Measures against defocus Tact time improvement

特長 Feature

- 高純度樹脂パッドを採用。
Prepare two types of anti-slip type and absorption type
- 耐熱温度：-30℃～150℃（連続使用温度）大気中・真空中で使用可能です。
Heat-resistant temperature: 150 °C (continuous use temperature)
- ミニマムコンタクトにより、デフォーカスの原因となるウェハ裏面の傷やパーティクルの付着を低減する事が可能です。
By minimized contact, possible to reduce scratches on the back side of the wafer and adhesion of particles which cause defocusing.
- Ion Padは優れた滑り止め性能を有し、高速搬送や高精度搬送を実現する事が可能です。
Anti-slip effect is outstanding, possible to achieve high-speed conveyance and high-precision conveyance.
- 大幅な設計変更を必要としない為、既存装置への導入が容易です。
Without required a significant design change, it is easy to introduce it to existing equipment.

